

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 光机电 >> 塑料生物芯片的激光焊接和封装技术研究

请输入查询关键词

科技频道

搜索

## 塑料生物芯片的激光焊接和封装技术研究

关键词: **封装** **激光焊接** **生物芯片**

所属年份: 2007

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 华中科技大学

成果摘要:

该技术的特点是: 激光加热键合的热影响区小, 键合速度高, 非接触加热, 污染小, 传统的超声键合和胶接键合都属于接触式键合, 热影响区大, 易引起污染; 控制激光的能量密度和作用时间可以在材料表面的局部产生瞬时高温并熔融, 但其他区域仍处于室温, 由于作用时间短, 作用区域小, 因而对周围的区域影响小, 热畸变亦小; 通过采用一种近红外吸收染料, 产生透明的键合线, 可实现多层芯片的键合。

成果完成人:

[完整信息](#)

### 行业资讯

塔北地区高精度卫星遥感数据处理

综合遥感技术在公路深部地质...

轻型高稳定度干涉成像光谱仪

智能化多用途无人机对地观测技术

稳态大视场偏振干涉成像光谱仪

2001年土地利用动态遥感监测

新疆特克斯河恰甫其海综合利...

用气象卫星资料反演蒸散

天水陇南滑坡泥石流遥感分析

综合机载红外遥感测量系统及...

### 成果交流

### 推荐成果

- [容错控制系统综合可信性分析...](#) 04-23
- [基于MEMS的微型高度计和微型...](#) 04-23
- [基于MEMS的载体测控系统及其...](#) 04-23
- [微机械惯性仪表](#) 04-23
- [自适应预估控制在大型分散控...](#) 04-23
- [300MW燃煤机组非线性动态模型...](#) 04-23
- [先进控制策略在大型火电机组...](#) 04-23
- [自动检测系统化技术的研究与应用](#) 04-23
- [机械产品可靠性分析--故障模...](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题

国家科技成果网

京ICP备07013945号